

2022年3月期上期

決算説明会資料

2021年11月11日



注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、新型コロナウイルス等の感染症を含め、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。

1

2022年3月期上期実績

2

2022年3月期通期予想

3

今後の戦略

旺盛な需要に支えられ、上期は大幅な増収増益で着地

- 車載受注は、期初から好調に推移
- スマホ、AI家電/IoT、EMSは、
半導体不足の影響が緩和傾向に転換
- コロナ影響で、8月から9月上旬に武漢・ベトナムで稼働調整
その後は全工場フル生産で推移
→ 新型コロナウイルス感染症による稼働調整の費用を
特別損失として約6億円を計上
- 広州工場は電力制限の影響を受けた
- 資源価格の高騰は、販売価格の見直しにより対応

2022年3月期上期 連結実績

(単位：億円)

	2021年 3月期 上期実績	2022年 3月期 上期実績	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高	532	695	163	30.5%
営業利益	18 3.4%	55 8.0%	37	205.8%
経常利益	6 1.1%	53 7.7%	47	854.3%
当期純利益	2 0.4%	42 6.0%	40	2052.5%
期中平均為替レート (JPY / USD)	106.30	110.12		
1株当たり配当金	0円	20円		

2022年3月期上期 商品別実績

(単位：億円)

	2021年 3月期 上期実績		2022年 3月期 上期実績		前年同期比	
	売上	営業利益 営業利益率	売上	営業利益 営業利益率	売上 伸び率	営業利益 伸び率
車 載	222	9 4.1%	348	29 8.3%	126 56.8%	20 222.2%
スマートフォン タブレット	127	10 7.9%	146	16 11.0%	19 15.0%	6 60.0%
AI家電・IoT・ アミューズメント	50	1 2.0%	51	6 11.8%	1 2.0%	5 500.0%
その他商品	78	0 0.0%	97	5 5.2%	19 24.4%	5 -
E M S	55	-2 -3.6%	53	-1 -1.9%	-2 -3.6%	1 -
合 計	532	18 3.4%	695	55 8.0%	163 30.5%	37 205.8%

1

2022年3月期上期実績

2

2022年3月期通期予想

3

今後の戦略

通期業績予想を上方修正

- 車載受注は、足元は電子部品や加工部品の不足により減少
- スマホ、AI家電/IoT、EMS受注は、堅調に推移
- 中国の電力制限と資源価格の上昇により調達価格が上昇

2022年3月期通期 連結予想

(単位：億円)

	2022年 3月期 上期実績	2022年度 3月期 下期予想	2022年度 3月期 通期予想	期初予想	増減額
売上高	695	755	1,450	1,350	100
営業利益	55	65	120	95	25
	8.0%	8.6%	8.3%	7.0%	1.3%
経常利益	53	57	110	87	23
	7.7%	7.5%	7.6%	6.4%	1.2%
当期純利益	42	49	90	75	15
	6.0%	6.5%	6.2%	5.6%	0.6%
期中平均為替レート (JPY/USD)	110.12	112	111.06	108	
1株当たり配当金	20円	20円	40円	40円	

2022年3月期通期 商品別予想

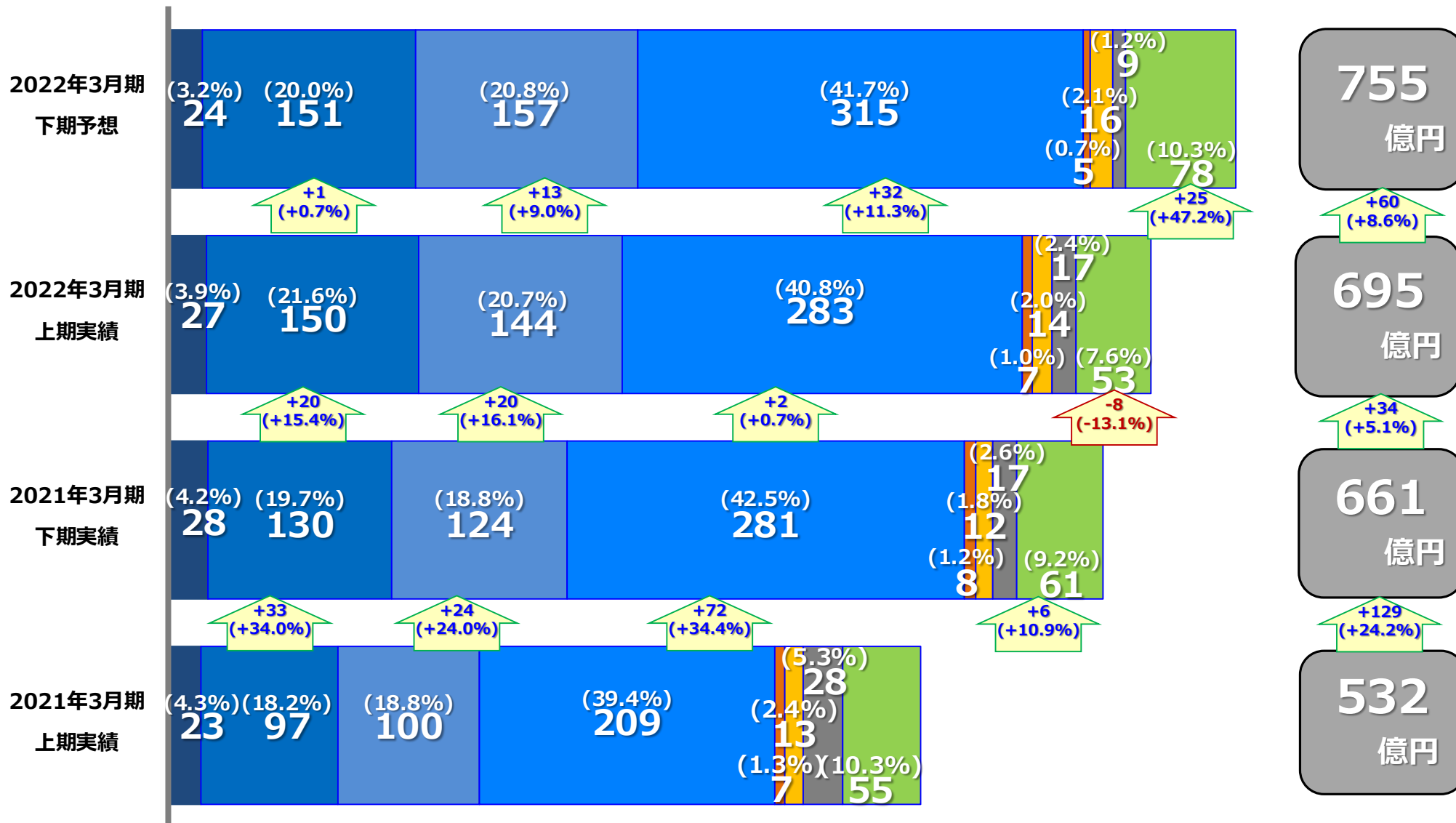
(単位：億円)

	2022年 3月期 上期実績		2022年 3月期 下期予想		2022年 3月期 通期予想	
	売上	営業利益 営業利益率	売上	営業利益 営業利益率	売上	営業利益 営業利益率
車 載	348	29 8.3%	363	31 8.5%	711	60 8.4%
スマートフォン タブレット	146	16 11.0%	164	19 11.6%	310	35 11.3%
AI家電・IoT・ アミューズメント	51	6 11.8%	56	7 12.5%	107	13 12.1%
その他商品	97	5 5.2%	94	5 5.3%	191	10 5.2%
E M S	53	-1 -1.9%	78	3 3.8%	131	2 1.5%
合 計	695	55 8.0%	755	65 8.6%	1,450	120 8.3%

2022年3月期 仕様別上期実績/下期予想

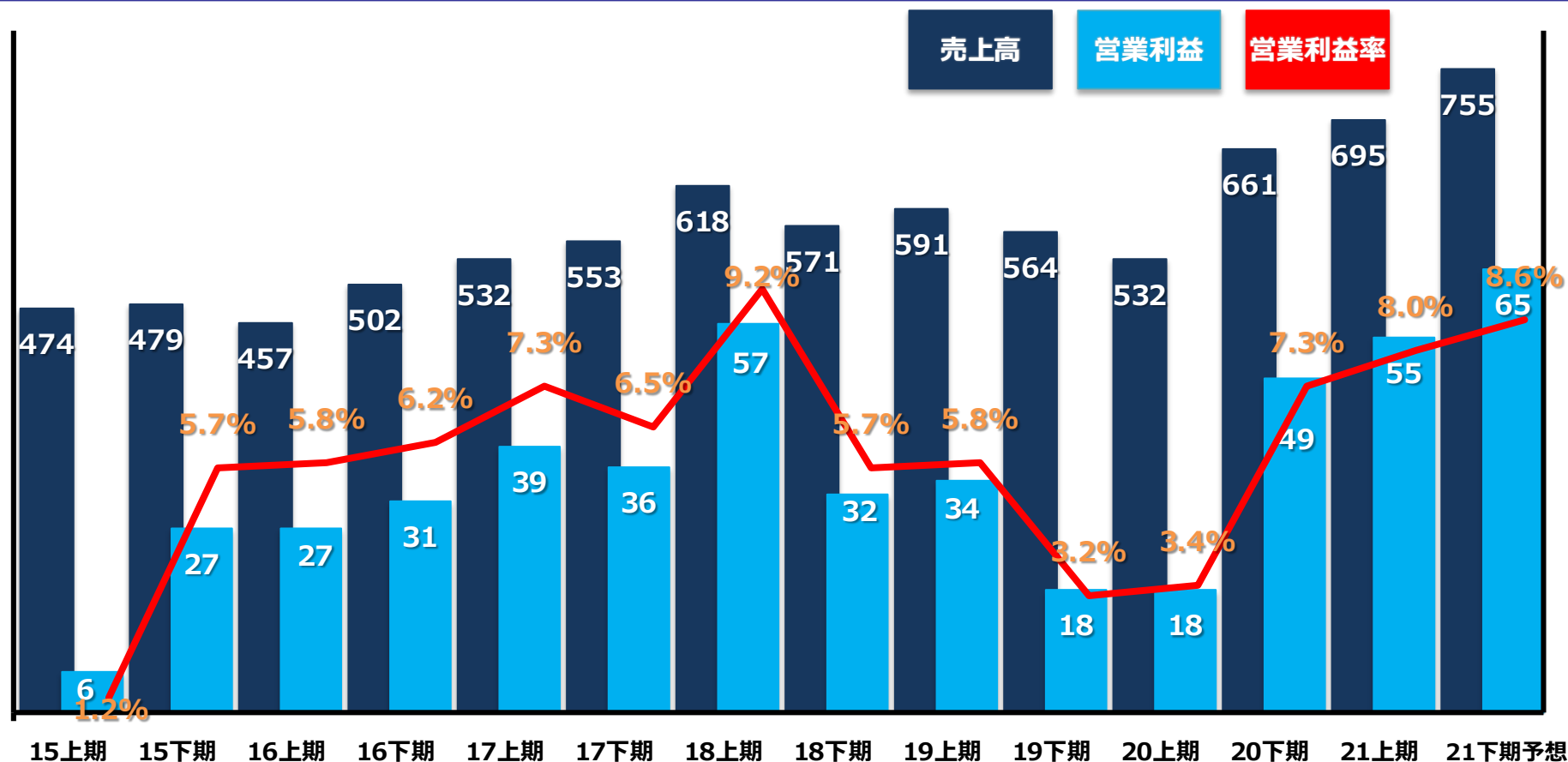
(単位：億円)

■ 両面板 ■ 4層板 ■ 6層板以上 ■ ビルドアップ ■ 放熱基板 ■ フレキ ■ その他 ■ EMS



売上高・営業利益他推移

(単位：億円)



投資額 (億円)	31	31	96	150	120	107	120
償却額 (億円)	64	55	58	63	69	74	77
DELシオ	2.5	2.0	1.4	1.7	2.0	1.9	1.4
自己資本比率	26.2%	27.3%	30.0%	27.8%	25.1%	28.6%	31.8%

サステナビリティへの取り組み

サステナビリティ 基本方針

メイコグループは企業理念に基づき、健全で透明性の高い経営と社会・環境に調和した事業活動を通じて、ステークホルダーの皆さまの信頼をより確かなものにするるとともに、社会の持続的発展への貢献と中長期的な企業価値の向上を図るため積極的にサステナビリティ活動を推進します。



取締役会

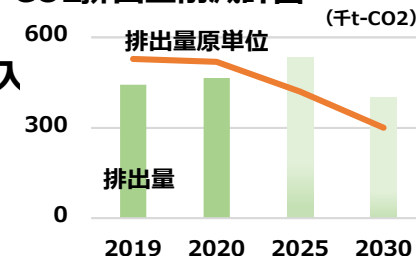
代表取締役
社長

サステナビリティ推進会議
《議長》専務取締役
メンバー：窓口部門

■ 環境

- CO2 削減
 - ◆ 再生エネルギー導入
 - ◆ 省エネ推進
- 資源リサイクル

CO2排出量削減計画



■ 社会

- 社会貢献活動
- 働きがいのある職場づくり
 - ◆ ダイバシティ推進
 - ◆ 女性活躍推進
 - ◆ グローバル人材の配置と交流



■ ガバナンス

- 取締役会の構成
- 広報・IR推進
 - ◆ ステークホルダーとの積極的対話の実施

	社外取締役	女性役員	外国人役員
取締役会の構成	4名	1名	1名

東京証券取引所 市場選択申請に関して

2021年7月9日 東京証券取引所より、
『新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する
一次判定結果』を受領

➡プライム市場の上場維持基準への適合を確認

この結果を踏まえ、当社はプライム市場を選択し、
東京証券取引所に申請することを決議

➡2021年11月8日
東京証券取引所へプライム市場選択申請書を提出

持続可能な成長による企業価値の向上を目指してまいります

1

2022年3月期上期実績

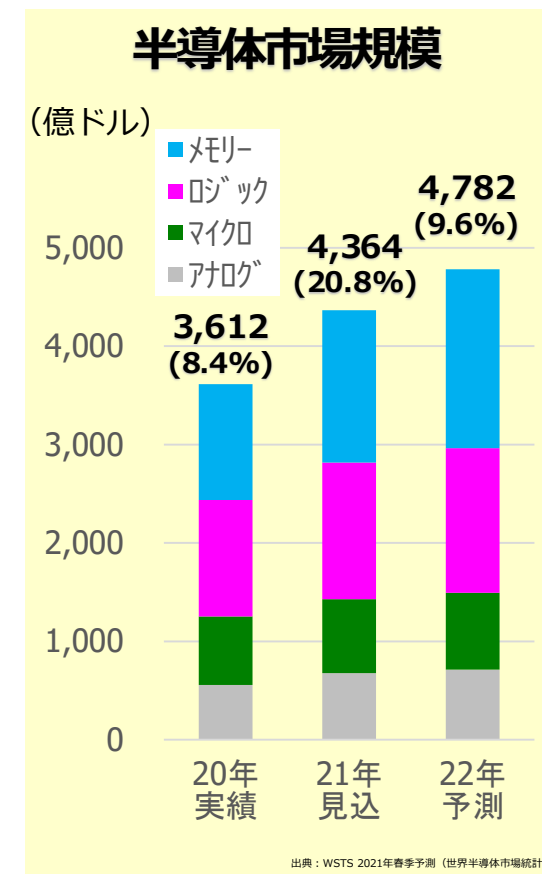
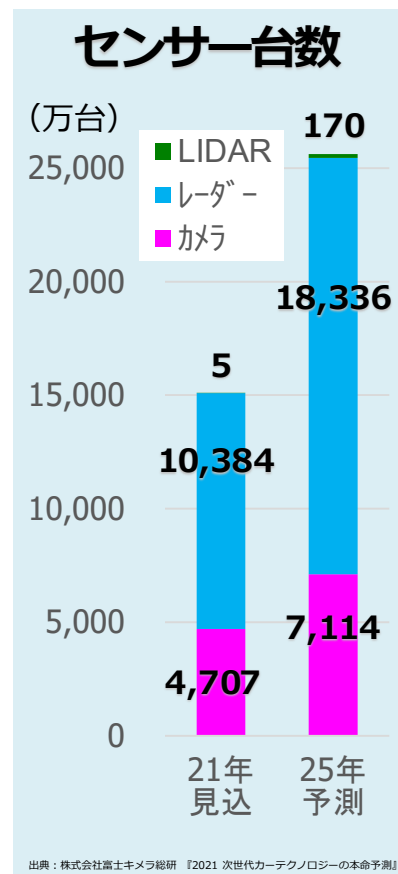
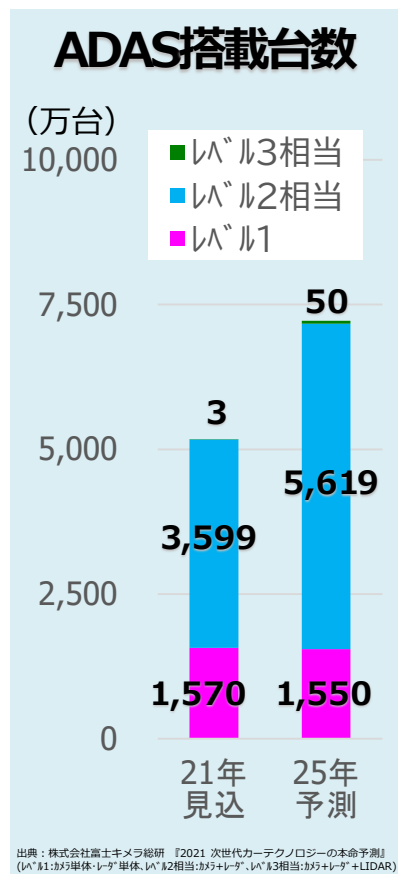
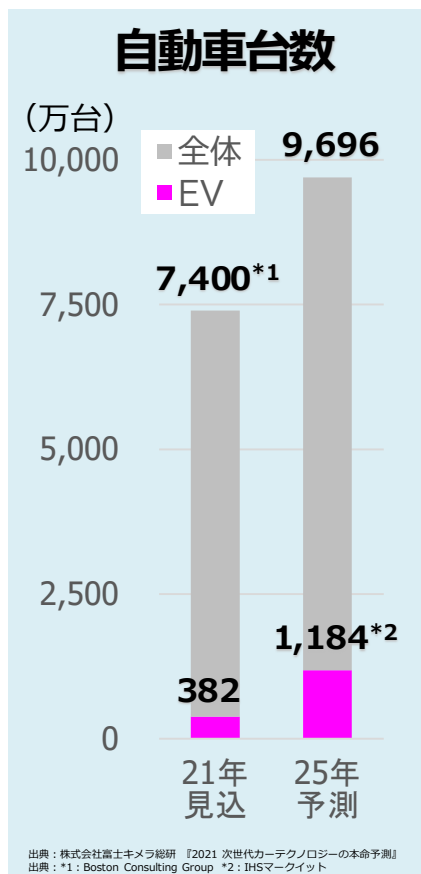
2

2022年3月期通期予想

3

今後の戦略

自動車市場および半導体市場の中期見通し



- 自動車台数、EV台数、ADAS搭載台数、センサー台数が増加し、車載基板の需要が拡大
- メモリーおよびロジックが増加、経済全体で半導体需要が拡大し、パッケージ基板の需要が拡大

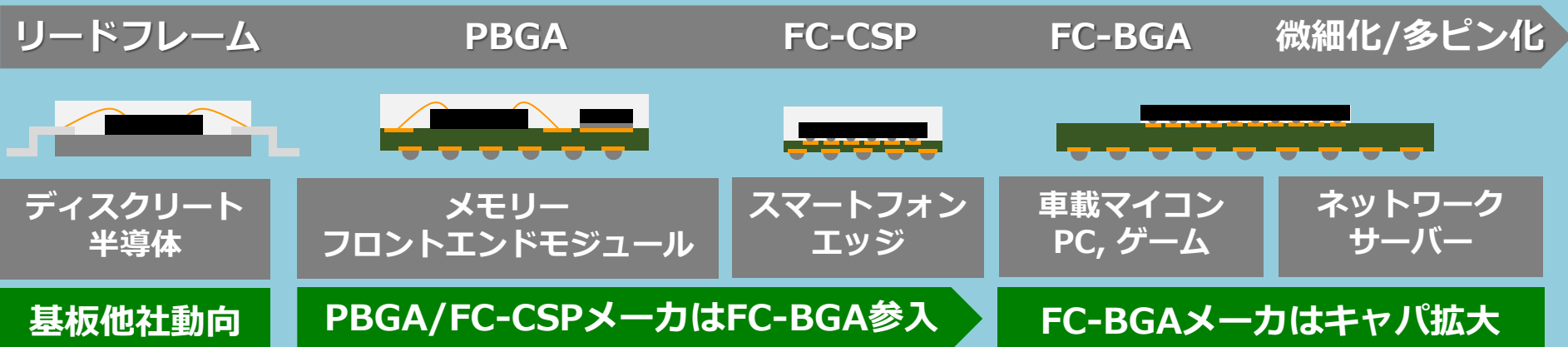
車載基板 技術ロードマップ

マクロ環境	2025年	2030年	2035年
自動運転 EV/FCV	ADAS義務化(22年~) 中国 レベル3 50%	米国 50%(PHV含む) 英国 全車	中国,日本 全車(HV含む) IEA,EU,加州 全車

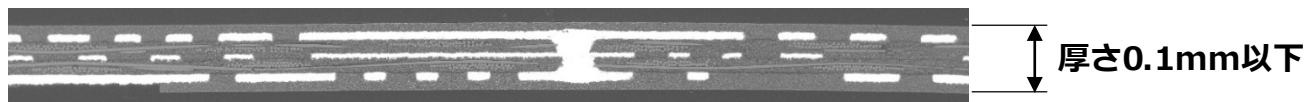
車載基板	2021年	2023年	2025年
コネクテッド (通信モジュール)	4G通信 TCU市場成長 (高密度化：10~12層エニ-レイヤー基板)		5G通信 本格普及 (基板サイズ大型化)
ADAS (センシング)	カメラ+レーダー+LIDAR 台数増加 (高周波材料ハイブリッド構造基板)		次世代ミリ波検討 (100GHz帯 高周波材料)
ADAS (E/Eアーキテクチャ)	分散型ECU⇒ドメイン統合型ECUへ移行 (高密度化：スタックアップ基板、インピーダンス制御基板)		中央集権型ECUへ移行 (コンピュータ基板)
EV電動化 (パワー素子放熱)	電動ブレーキ、電動パワーステアリング、 LEDヘッドランプ 台数増加 (放熱基板、FR-4フレックス基板)		800V 高電圧化 (高放熱・高耐圧基板)

モジュール・パッケージ基板 技術ロードマップ

半導体パッケージ動向



基板	2021年	2023年	2025年
パッケージ タイプ	PBGA (メモリー/フロントエンドモジュール)	PBGA / FC-CSP (アプリケーション拡大)	
回路形成	MSAP (L/S=25/25um)	MSAP (L/S=20/20um)	
	SAP開発	SAP生産	



パッケージ基板断面

山形新事業所について

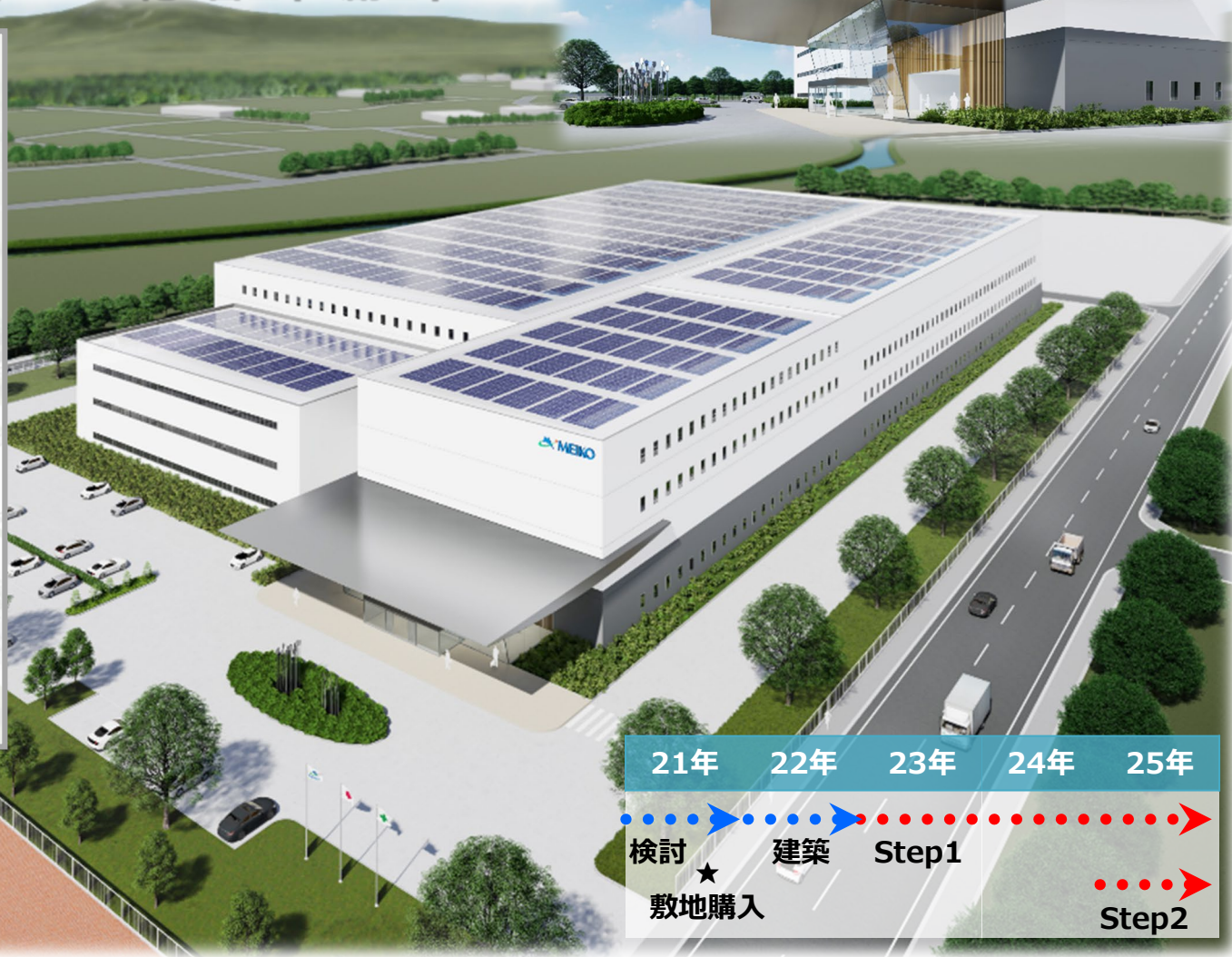
【工場コンセプト】 国内最先端エコスマート工場

➔ 最新IT・FA化・省エネ・創エネ

- 1) 所在地 : 山形県天童市
- 2) 敷地面積 : 約65,000m²
- 3) 延床面積 : 約25,000m²(Step1)
約45,000m²(Step2)
- 4) 売上規模 : 約100億円/年(Step1)
約200億円/年(Step2)
- 5) 投資規模 : 約100億円(Step1)
約100億円(Step2)

6) 事業内容

- ①先端車載基板 量産工場
- ②基板技術 開発センター機能
- ③自動化設備 開発・製造
- ④EMS事業 国内展開



モジュール・パッケージ基板事業の強化

ベトナム第3工場



- 1) コンセプト：海外モジュール・パッケージ基板専用工場
- 2) 延床面積：約20,000m² 3) 投資規模：約160億円

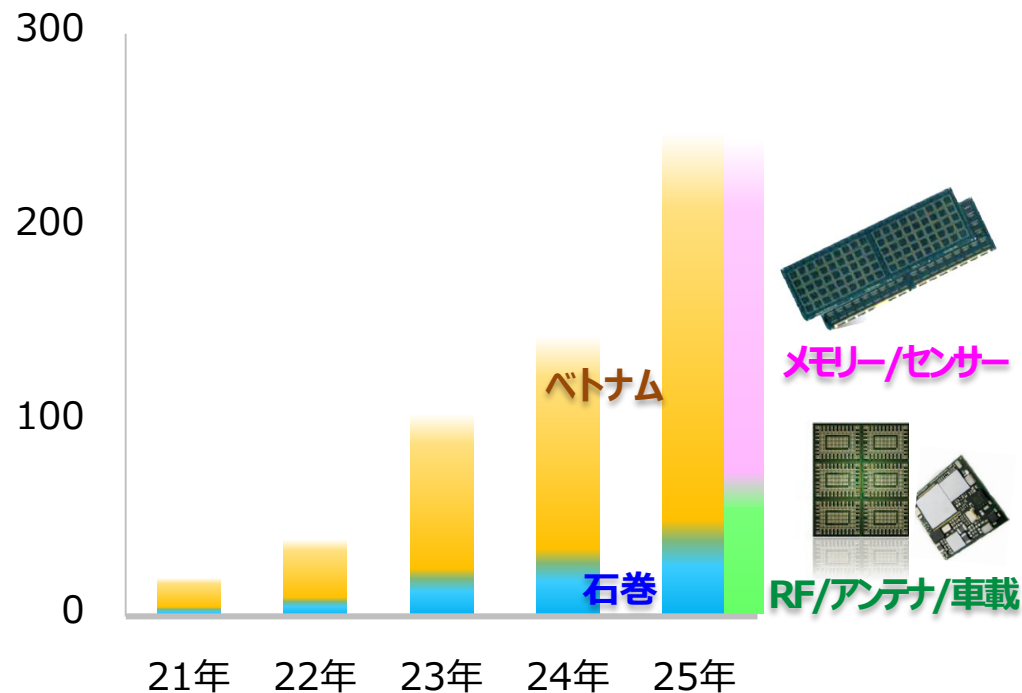
石巻第2工場



- 1) コンセプト：国内モジュール・パッケージ基板専用工場
- 2) 延床面積：約5,000m² 3) 投資規模：約50億円

モジュール・パッケージ基板事業売上計画

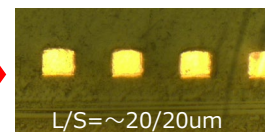
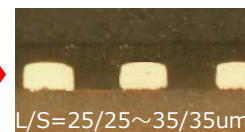
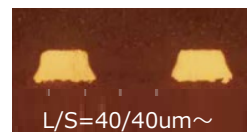
(億円)



サブトラ法

MSAP法 ※Modify Semi Additive Process

SAP法 ※Semi Additive Process



補足資料

2022年3月期 商品別上期実績/下期予想

(単位：億円)

■ 車載 ■ スマホタブレット ■ AI家電/IoT ■ アミューズメント ■ ストレージ ■ 事務機 ■ デジタル家電 ■ その他 ■ EMS

